

# 合肥晶合集成电路股份有限公司

## 2023 年年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

### 一、2023 年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	724,393.14	1,005,094.86	-27.93
营业利润	11,289.84	314,214.07	-96.41
利润总额	11,750.25	315,640.42	-96.28
归属于母公司所有者的净利润	21,007.28	304,543.08	-93.10
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	4,472.13	287,834.64	-98.45
基本每股收益（元）	0.11	2.02	-94.55
加权平均净资产收益率	1.08%	26.91%	减少 25.83 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	4,815,065.33	3,876,457.45	24.21
归属于母公司的所有者权益	2,140,824.83	1,312,415.66	63.12
股本	200,613.52	150,460.14	33.33
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	10.58	7.52	40.69

注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数；

2.以上财务数据及指标均以合并财务报表数据填列，未经审计，最终结果以公司 2023 年年度报告为准。数据如有尾差，为四舍五入所致。

## 二、经营业绩和财务状况情况说明

### （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内，公司实现营业总收入 724,393.14 万元，较上年同期下降 27.93%；实现归属于母公司所有者的净利润 21,007.28 万元，较上年同期下降 93.10%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 4,472.13 万元，较上年同期下降 98.45%。

报告期末，公司总资产 4,815,065.33 万元，较本报告期初增长 24.21%；归属于母公司的所有者权益 2,140,824.83 万元，较本报告期初增长 63.12%；归属于母公司所有者的每股净资产 10.58 元，较本报告期初增长 40.69%。

自 2022 年第三季度以来，全球集成电路行业进入下行周期，智能手机、笔记本电脑等消费电子市场下滑，市场整体需求放缓，供应链持续调整库存，导致全球晶圆代工面临不同程度的产能利用率下降及营收衰退，而公司成本结构中折旧、摊销等固定成本较高，导致公司营业收入和产品毛利水平同比下降。

自 2023 年第二季度开始，下游去库存情况取得一定的成效，市场需求开始回升，公司积极调整销售策略，加大市场开拓力度，同时提高生产效率。此外，在新技术新产品增量助益下，公司产能利用率逐步提升，在 2023 年底已再次达到 90% 以上，2023 年内营业收入和产品毛利水平稳步提升。2023 年第四季度，公司实现营业收入 222,705.06 万元，毛利率达到 28.36%。

### （二）上表中有关项目增减变动幅度达 30% 以上的主要原因

1、报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润和基本每股收益分别较上年同期下降 96.41%、96.28%、93.10%、98.45% 和 94.55%，主要系报告期内：

（1）终端消费市场低迷及固定成本较高的因素影响，公司营业收入和产品毛利水平同比下降；

(2) 公司持续推动技术迭代与创新，在 55nm-28nm 制程及车用芯片研发上持续加大投入，研发费用较 2022 年增加约 2 亿元，同比上升约 23%；

(3) 财务费用受汇率波动影响较 2022 年增加约 0.85 亿元，同比上升约 123%。

2、报告期内，公司归属于母公司的所有者权益、股本、归属于母公司所有者的每股净资产分别较上年同期上升 63.12%、33.33%、40.69%，主要系报告期内公司首次公开发行股票收到募集资金，股本和资本公积相应增加所致。

### 三、风险提示

本公告所载的 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司 2023 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据请以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2024 年 2 月 24 日